

【プレスリリース】

報道関係各位

2025年12月22日

アプライド株式会社

省スペース筐体で性能を最大限に引き出す

冷却・エアフロー設計を徹底追求した

HPC／ワークステーション「CERVO」シリーズを強化

— 「CERVO SLIM」「CERVO MICRO」「CERVO CUBOID」新モデルを順次発売 —

アプライド株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：岡 義治）は、HPC（High Performance Computing）およびプロフェッショナル用途に向けたオリジナルワークステーション「CERVO」シリーズにおいて、省スペース筐体でありながら高負荷時も安定動作を実現する冷却・エアフロー設計を強化した【高性能・省スペース・GPU搭載】を特長とする新製品ラインアップを発表いたします。

今回新たに、

3モデルを強化・刷新し、用途や設置環境に応じて最適な選択が可能な製品群として展開してまいります。

・ CERVO SLIM

・ CERVO MICRO

・ CERVO CUBOID



■ 開発コンセプト

「小さくても、性能は妥協しない」

AI 演算、GPU コンピューティング、3D 処理などの高負荷用途では、

CPU・GPU の性能だけでなく、冷却性能とエアフロー設計が実効性能を大きく左右します。

CERVO シリーズでは、単なる小型化ではなく、

- 発熱源の配置最適化
- 吸排気経路の最短化
- 内部エアフローの乱れを抑える筐体構造
- 長時間高負荷運用を前提とした冷却マージン確保

といった設計思想を採用し、

省スペース環境でも CPU・GPU の性能をフルに引き出すワークステーションを実現しました。

■ 冷却・エアフロー設計の特長（共通）

- コンパクト筐体専用の冷却レイアウト
小型筐体に最適化したファン配置と風量設計
- 高負荷連続稼働を想定した熱設計
AI 学習・解析・レンダリングなど長時間運用でも安定動作
- GPU 搭載時の排熱効率を重視
GPU 周辺の熱溜まりを抑制し、性能低下を防止
- 静音性と冷却性能のバランス
オフィス・研究室環境にも配慮した設計

■ 各モデルの特長

・ CERVO SLIM

スリム筐体でありながら、高性能CPU・GPU構成に対応。

前面から背面へ直線的なエアフロー設計により、デスクサイド設置でも安定した冷却性能を実現。

・ CERVO MICRO

小型筐体ながら、限られた空間で効率的に熱を排出するエアフローを構築。

検証環境やエッジ用途でも高い信頼性を発揮。

・ CERVO CUBOID

コンパクトな筐体サイズの中で、冷却とエアフローを徹底的に最適化。

高発熱なGPUを標準搭載しながらも、熱を溜め込まない設計により、

AI処理やGPUコンピューティングなどの連続高負荷作業を安定して支えます。

■ 想定用途

- AI／ディープラーニング開発
- 画像解析・映像制作
- CAD／CAE／3Dモデリング
- 研究機関・教育機関での演算用途
- 企業内R&D、技術検証環境

■ 今後の展開

アプライドでは、CERVOシリーズを通じて「省スペース×高性能×安定稼働」を重視する法人・研究用途市場に向け、ハードウェア設計から導入支援、運用サポートまでを含めたHPC/ワークステーションソリューションを強化してまいります。

■ 関連サイト

HPC・AI サイト <https://bto.applied.ne.jp/>

BTO サイト <https://bto-pc.applied.ne.jp/>

アプライドネット <https://shop.applied-net.co.jp/>

■ アプライド株式会社の概要

所在地：〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-3-1

代表者：代表取締役 岡 義治

設立：1982 年 9 月 20 日

資本金：3 億 8,173 万円

事業内容：PC および周辺機器の販売、BTO/HPC 製品の製造販売、ネットワークシステム

■ 本件に関するお問い合わせ

アプライド株式会社 総務部 山口 圭介

電話：092-481-7801 FAX：092-481-9965